

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成24年11月22日(2012.11.22)

【公開番号】特開2011-251493(P2011-251493A)

【公開日】平成23年12月15日(2011.12.15)

【年通号数】公開・登録公報2011-050

【出願番号】特願2010-127831(P2010-127831)

【国際特許分類】

B 3 2 B 27/00 (2006.01)

B 3 2 B 27/30 (2006.01)

B 6 5 D 73/02 (2006.01)

B 6 5 D 85/86 (2006.01)

【F I】

B 3 2 B 27/00 L

B 3 2 B 27/30 A

B 6 5 D 73/02 H

B 6 5 D 73/02 K

B 6 5 D 85/38 N

【手続補正書】

【提出日】平成24年10月3日(2012.10.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基材層上に、少なくともヒートシーラント層を備えた電子部品包装用カバーテープであつて、

前記ヒートシーラント層がベース樹脂と有機フィラーとを含み、

前記ベース樹脂と有機フィラーとの屈折率の差が0.1以下であり、

前記有機フィラーの粒度分布幅(D90/D10)が10以下であることを特徴とする電子部品包装用カバーテープ。

【請求項2】

前記ベース樹脂がアクリル系樹脂を主成分とするものである請求項1記載の電子部品包装用カバーテープ。

【請求項3】

前記ベース樹脂が少なくとも2種以上のモノマー成分からなる共重合体である請求項2記載の電子部品包装用カバーテープ。

【請求項4】

前記モノマー成分のうち少なくとも一種がメタクリル酸ブチルである請求項3記載の電子部品包装用カバーテープ。

【請求項5】

前記ヒートシーラント層は、前記ベース樹脂100重量部に対して、前記有機フィラーを0.1~10重量部含有するものである請求項1乃至4のいずれかに記載の電子部品包装用カバーテープ。

【請求項6】

請求項1乃至5のいずれか1項に記載の電子部品包装用カバーテープと電子部品包装用

キャリアテープとがヒートシールされて得られた電子部品包装体であって、前記ヒートシーラント層と前記キャリアテープとが所定の領域でヒートシールされている電子部品包装体。